

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 11 月 22 日(22.11.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/157599 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01) H01L 21/607 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/062275
- (22) 国際出願日: 2012 年 5 月 14 日(14.05.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-110093 2011 年 5 月 17 日(17.05.2011) JP
特願 2012-096242 2012 年 4 月 20 日(20.04.2012) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社新川 (SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 萩原 美仁 (HAGIWARA, Yoshihito) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP). 関根 直希 (SEKINE, Naoki) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP). 高橋 浩一 (TAKAHASHI, Koichi) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1

株式会社新川内 Tokyo (JP). 長島 康雄 (NAGASHIMA, Yasuo) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP). 中澤 基樹 (NAKAZAWA, Motoki) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特許事務所 (YKI Patent Attorneys); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目 3 4 番 1 2 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

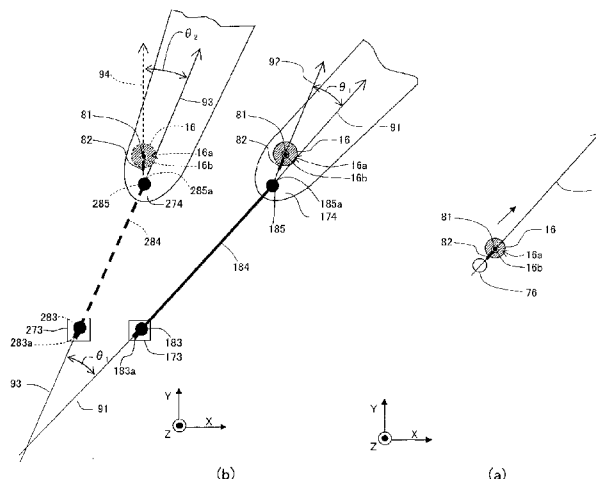
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

[続葉有]

(54) Title: WIRE BONDING DEVICE AND BONDING METHOD

(54) 発明の名称: ワイヤボンディング装置及びボンディング方法

[図6]



(57) Abstract: A wire bonding device (10) has a bonding tool (16) that has a through hole (16b) and a pressing pressure surface (16a) that applies pressing pressure to a wire, a clasper (17) that grasps and holds a wire (81) and a control section (30). The control section (30) has a wire tail extending means that raises the bonding tool (16) after wedge bonding of the wire (81) to a first lead (174), moves the same along a second straight line (93) that joins a second pad (273) and second lead (274), and extends the wire (81) from the through hole (16b) of the bonding tool (16) in a direction along the second straight line (93) from the second pad (273) toward the second lead (274) and a tail cutting means that after extending a wire tail (82), closes the clasper (17), moves the bonding tool (16) along the second straight line (93) that joins the second pad (273) and the second lead (274), and cuts the wire tail (82). Thus, a wire bonding device that can carry out high speed wedge wire bonding is provided.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/157599 A1